

2020年3月期 第2四半期決算説明会

2019年11月15日

株式会社フジミインコーポレーテッド

決算概要

決算概要 (上期実績)

単位：百万円	19年3月期		20年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想('19/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	上期予想比('19/5)
売上高	19,163	18,231	18,000	18,884	△1.5%	+3.6%	+4.9%
営業利益	2,813	2,497	2,000	2,863	+1.8%	+14.7%	+43.2%
営業利益率	14.7%	13.7%	11.1%	15.2%	-	-	-
経常利益	3,056	2,580	2,050	2,974	△2.7%	+15.3%	+45.1%
経常利益率	15.9%	14.2%	11.4%	15.8%	-	-	-
四半期純利益	2,339	1,926	1,550	2,212	△5.5%	+14.9%	+42.7%
四半期純利益率	12.2%	10.6%	8.6%	11.7%	-	-	-

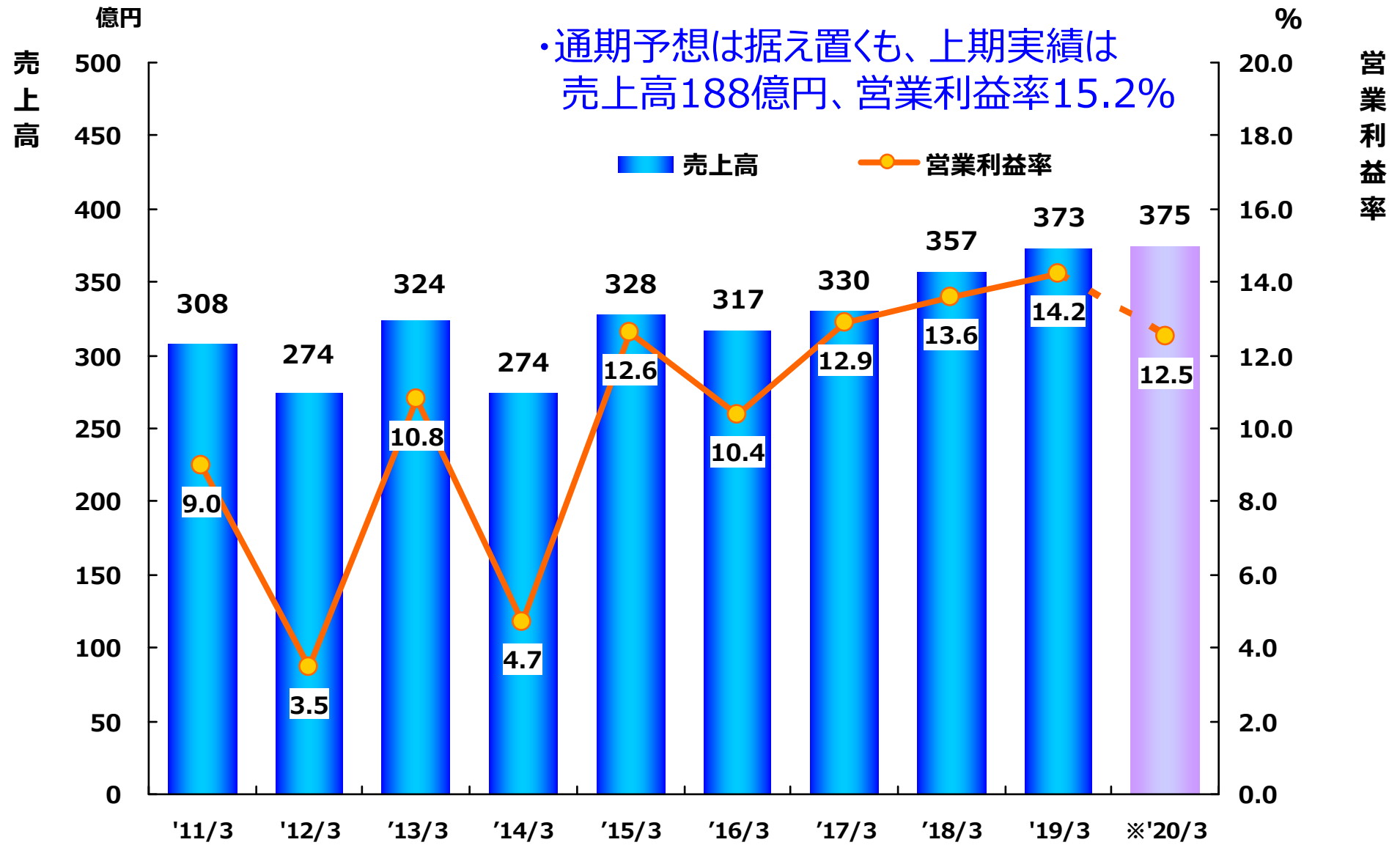
- ・売上は前年同期比微減、販管費増加なるも、製品構成が良化し営業増益
- ・ただし、為替差益は前年同期比減（前期上期140→今期上期7）となり経常減益

業績予想（通期予想）

単位：百万円	19年3月期	20年3月期			
	通期実績	期初予想 ('19/5)	修正予想 ('19/11)	前期比	期初予想比 ('19/5)
売上高	37,394	37,500	37,500	+0.3%	-
営業利益	5,310	4,700	4,700	△11.5%	-
営業利益率	14.2%	12.5%	12.5%	-	-
経常利益	5,637	4,800	4,800	△14.8%	-
経常利益率	15.1%	12.8%	12.8%	-	-
当期純利益	4,265	3,600	3,600	△15.6%	-
当期純利益率	11.4%	9.6%	9.6%	-	-

・半導体市況の先行きが見通し難いことから、5月10日公表の通期予想を据え置き

業績推移 (通期)



※'20/3は予想値

用途別売上高

用途別売上高 (上期実績)

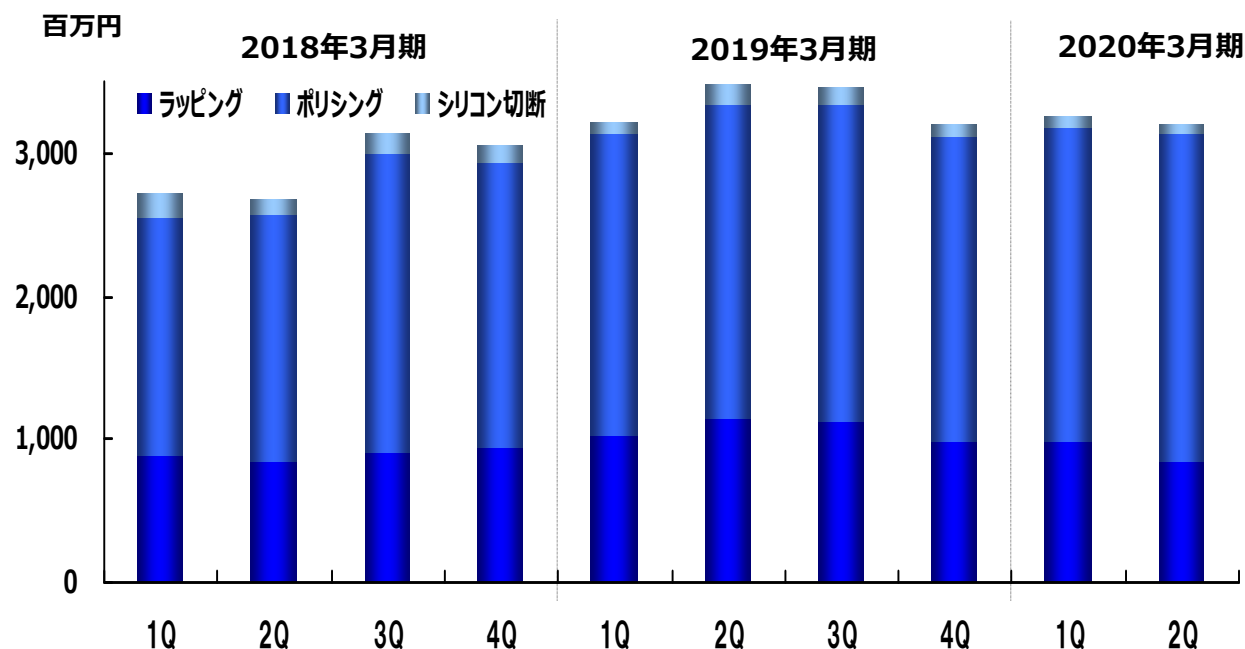
単位：百万円		19年3月期		20年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('19/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('19/5)
シリコンウェハー	ラッピング	2,176	2,120	2,300	1,834	△15.7%	△13.5%	△20.3%
	ポリシング	4,301	4,319	4,350	4,487	+4.3%	+3.9%	+3.1%
	切断	228	225	150	137	△40.0%	△39.3%	△8.7%
	計	6,706	6,666	6,800	6,458	△3.7%	△3.1%	△5.0%
CMP		7,690	7,614	7,200	8,483	+10.3%	+11.4%	+17.8%
ディスク	アルミディスク	1,225	946	830	983	△19.8%	+3.9%	+18.4%
	ガラスディスク	51	45	70	111	+117.3%	+145.7%	+58.6%
	計	1,276	991	900	1,094	△14.3%	+10.4%	+21.5%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,212	1,718	1,950	1,740	△21.4%	+1.2%	△10.8%
	一般工業用(非研磨材)	1,070	1,051	1,000	949	△11.4%	△9.7%	△5.1%
	計	3,283	2,769	2,950	2,689	△18.1%	△2.9%	△8.9%
製品売上高		18,957	18,042	17,850	18,724	△1.2%	+3.8%	+4.9%
商品売上高		206	189	150	160	△22.4%	△15.5%	+6.6%
売上高 合計		19,163	18,231	18,000	18,884	△1.5%	+3.6%	+4.9%

シリコンウェハー売上高（上期実績）

「上期」

単位：百万円

		19年3月期		20年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('19/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('19/5)
シリコンウェハー	ラッピング	2,176	2,120	2,300	1,834	△15.7%	△13.5%	△20.3%
	ポリシング	4,301	4,319	4,350	4,487	+4.3%	+3.9%	+3.1%
	切断	228	225	150	137	△40.0%	△39.3%	△8.7%
計		6,706	6,666	6,800	6,458	△3.7%	△3.1%	△5.0%



- ・シリコンウェハー市場軟調
- ・ラッピング向け製品：シリコンウェハー市場の減速により減収
- ・ポリシング向け製品：一次・二次研磨工程での採用拡大により増収

シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

		19年3月期		20年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 19/5)	下期修正予想 (' 19/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 19/5)
シリコンウェハー	ラッピング	2,176	2,120	1,834	2,400	2,326	+9.7%	+26.8%	△3.1%
	ポリシング	4,301	4,319	4,487	4,850	4,853	+12.3%	+8.2%	+0.1%
	切断	228	225	137	150	163	△27.8%	+19.0%	+8.6%
	計	6,706	6,666	6,458	7,400	7,342	+10.1%	+13.7%	△0.8%

「通期」

単位：百万円

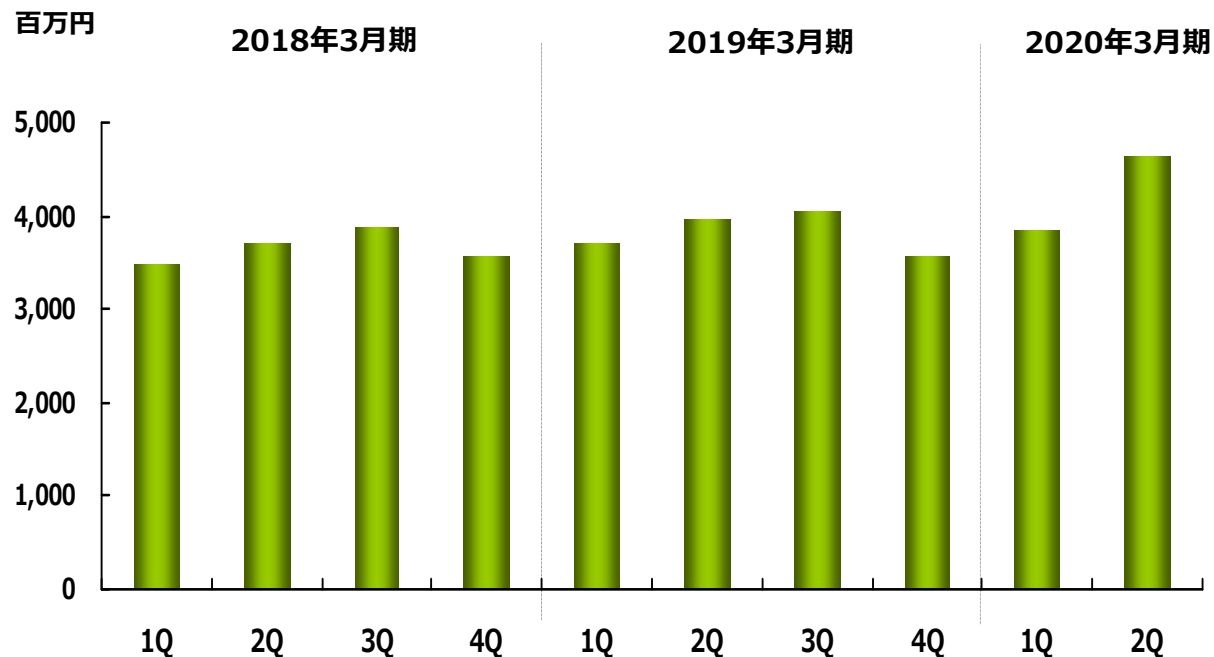
		18年3月期	19年3月期	20年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 19/5)	通期修正予想 (' 19/11)	前期比	期初予想比 (' 19/5)
シリコンウェハー	ラッピング	3,588	4,297	4,700	4,160	△3.2%	△11.5%
	ポリシング	7,472	8,621	9,200	9,340	+8.3%	+1.5%
	切断	535	453	300	300	△33.9%	+0.0%
	計	11,596	13,373	14,200	13,800	+3.2%	△2.8%

CMP売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

	19年3月期		20年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('19/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('19/5)
CMP	7,690	7,614	7,200	8,483	+10.3%	+11.4%	+17.8%



・メモリデバイス市況は停滞したものの、最先端半導体デバイス向け製品の販売増加により増収

・ロジックデバイス市況は春先以降、回復したことにより増収

CMP売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

	19年3月期		20年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('19/5)	下期修正予想 ('19/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('19/5)
CMP	7,690	7,614	8,483	7,600	7,117	△6.5%	△16.1%	△6.4%

「通期」

単位：百万円

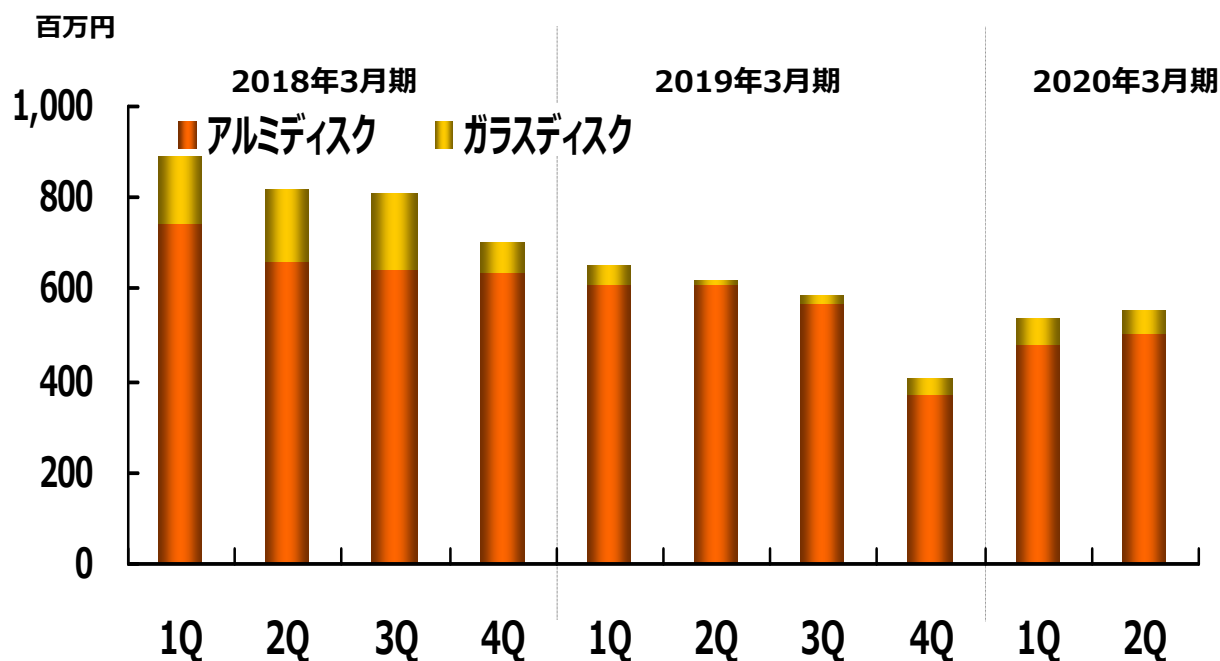
	18年3月期	19年3月期	20年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想 ('19/5)	通期修正予想 ('19/11)	前期比	期初予想比 ('19/5)
CMP	14,621	15,305	14,800	15,600	+1.9%	+5.4%

ディスク売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		19年3月期		20年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('19/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('19/5)
ディスク	アルミディスク	1,225	946	830	983	△19.8%	+3.9%	+18.4%
	ガラスディスク	51	45	70	111	+117.3%	+145.7%	+58.6%
	計	1,276	991	900	1,094	△14.3%	+10.4%	+21.5%



・アルミディスク向け製品は市場縮小（SSDへの移行）と顧客のプロセス変更により減収

・ただし、データセンター及びPC向けの需要が回復していることにより、予想を18%上回った

ディスク売上高 (下期予想・通期予想)

「下期」

単位：百万円

		19年3月期		20年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('19/5)	下期修正予想 ('19/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('19/5)
ディスク	アルミディスク	1,225	946	983	1,070	917	△3.1%	△6.7%	△14.3%
	ガラスディスク	51	45	111	30	139	+207.6%	+25.2%	+362.2%
	計	1,276	991	1,094	1,100	1,056	+6.5%	△3.5%	△4.0%

「通期」

単位：百万円

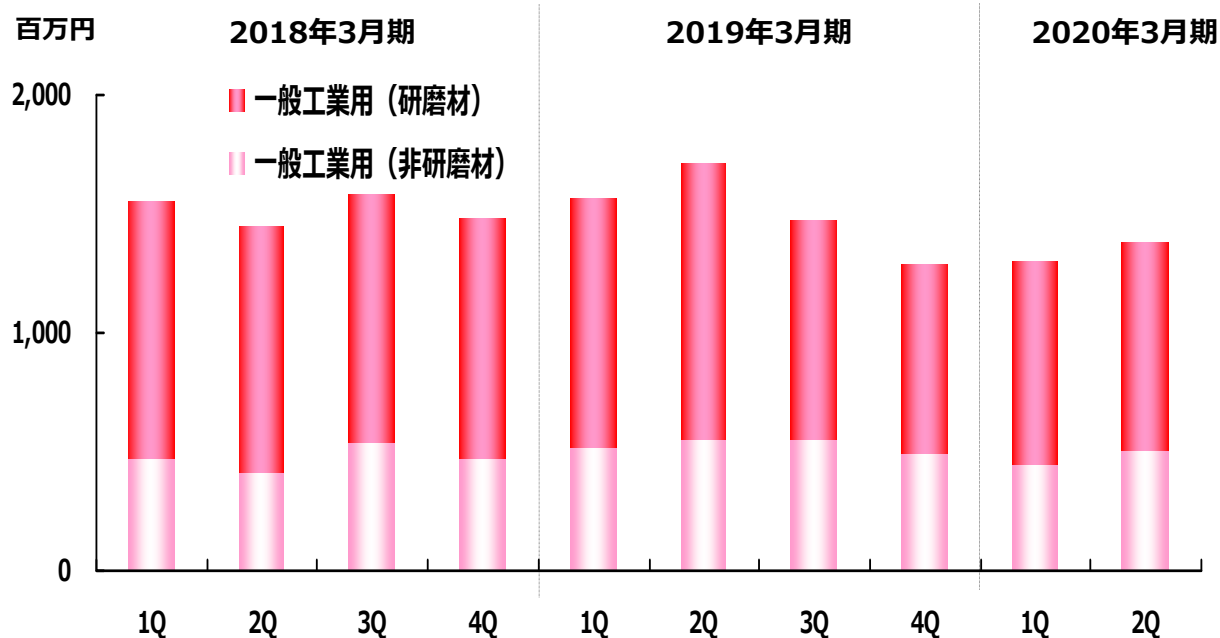
		18年3月期	19年3月期	20年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('19/5)	通期修正予想 ('19/11)	前期比	期初予想比 ('19/5)
ディスク	アルミディスク	2,694	2,171	1,900	1,900	△12.5%	+0.0%
	ガラスディスク	542	96	100	250	+159.7%	+149.8%
	計	3,236	2,268	2,000	2,150	△5.2%	+7.5%

機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		19年3月期		20年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想('19/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比('19/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,212	1,718	1,950	1,740	△21.4%	+1.2%	△10.8%
	一般工業用(非研磨材)	1,070	1,051	1,000	949	△11.4%	△9.7%	△5.1%
	計	3,283	2,769	2,950	2,689	△18.1%	△2.9%	△8.9%



・一般工業用（研磨材）：
 中国の景気減速に伴う需要減少等により減収

・一般工業用（非研磨材）：
 半導体・液晶製造装置向け溶射材の需要減少により減収

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

		19年3月期		20年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('19/5)	下期修正予想 ('19/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('19/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,212	1,718	1,740	2,050	1,810	+5.3%	+4.0%	△11.7%
	一般工業用(非研磨材)	1,070	1,051	949	1,200	1,151	+9.5%	+21.3%	△4.1%
	計	3,283	2,769	2,689	3,250	2,961	+6.9%	+10.1%	△8.9%

「通期」

単位：百万円

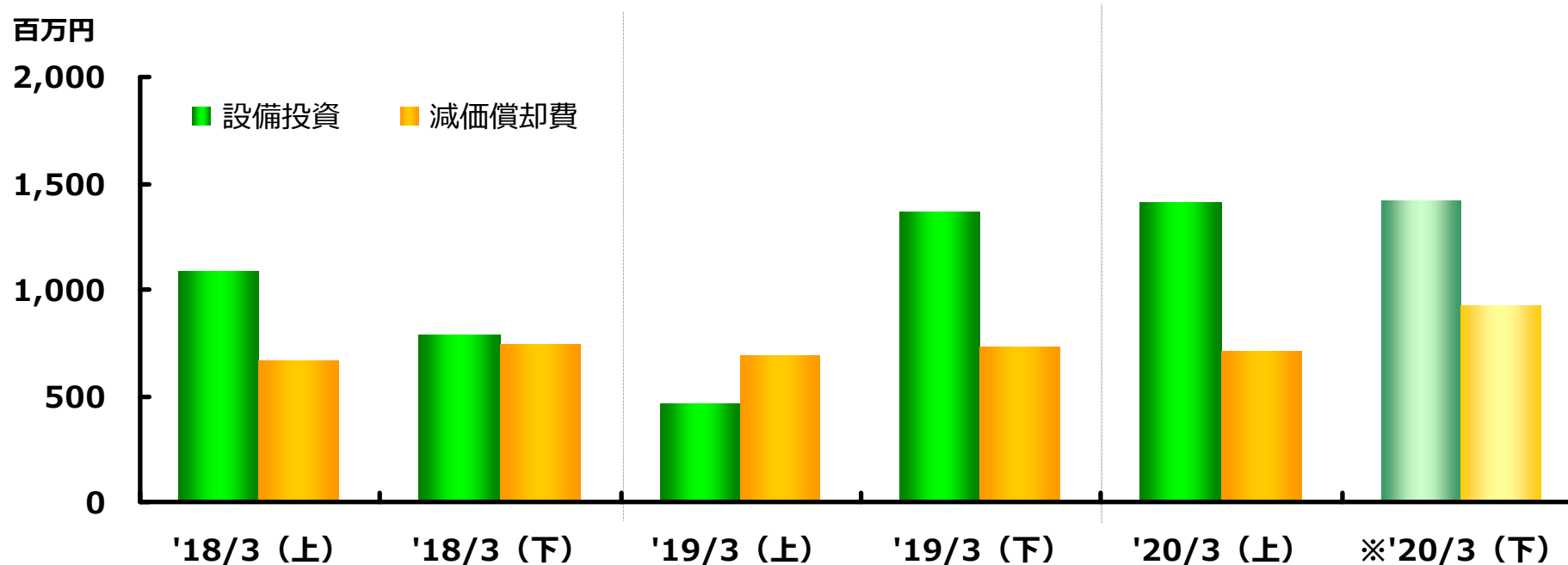
		18年3月期	19年3月期	20年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('19/5)	通期修正予想 ('19/11)	前期比	期初予想比 ('19/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,244	3,931	4,000	3,550	△9.7%	△11.3%
	一般工業用(非研磨材)	1,904	2,121	2,200	2,100	△1.0%	△4.6%
	計	6,149	6,053	6,200	5,650	△6.7%	△8.9%

設備投資額
減価償却費
研究開発費

設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

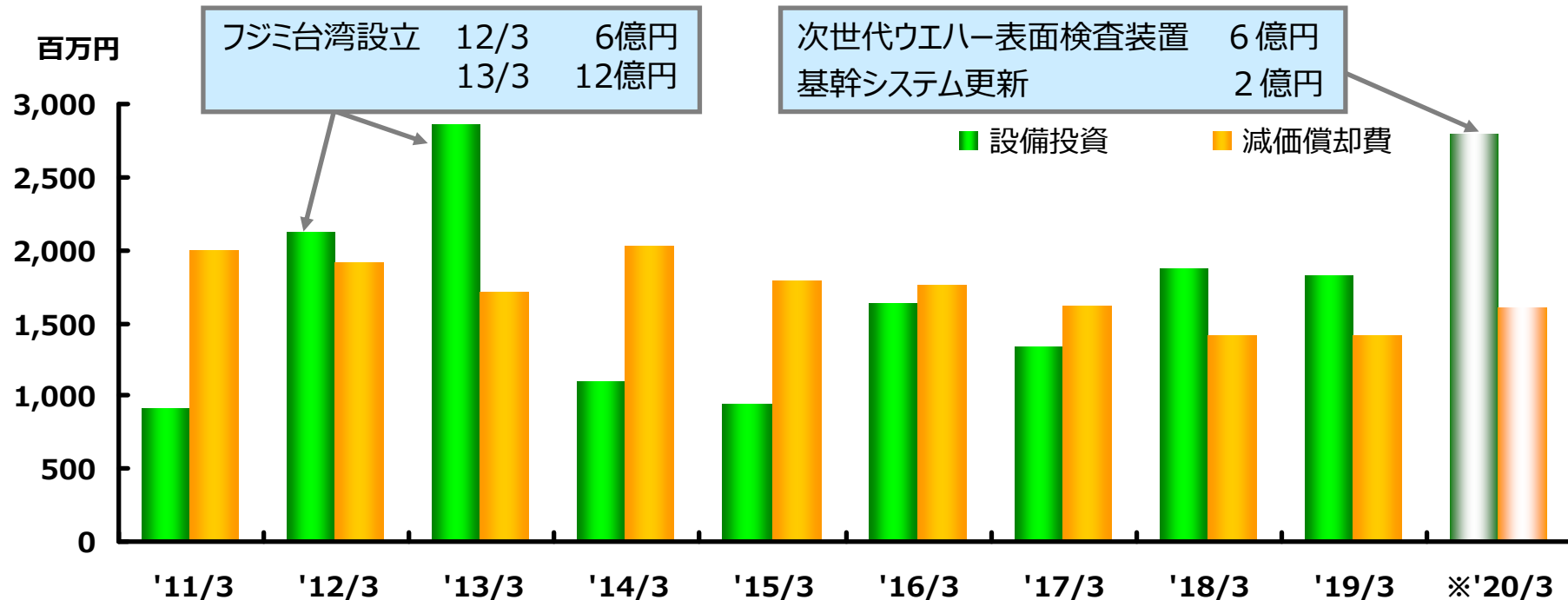
	19年3月期		20年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画('19/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比('19/5)	下期計画('19/5)	下期修正計画('19/11)	前年同期比	同年上期比	計画比('19/5)
設備投資額	461	1,368	1,500	1,409	+205.6%	+3.0%	△6.1%	1,600	1,391	+1.7%	△1.3%	△13.1%
減価償却費	684	729	800	715	+4.5%	△1.9%	△10.6%	1,000	885	+21.4%	+23.8%	△11.5%



設備投資額・減価償却費 (通期実績・通期計画)

単位：百万円

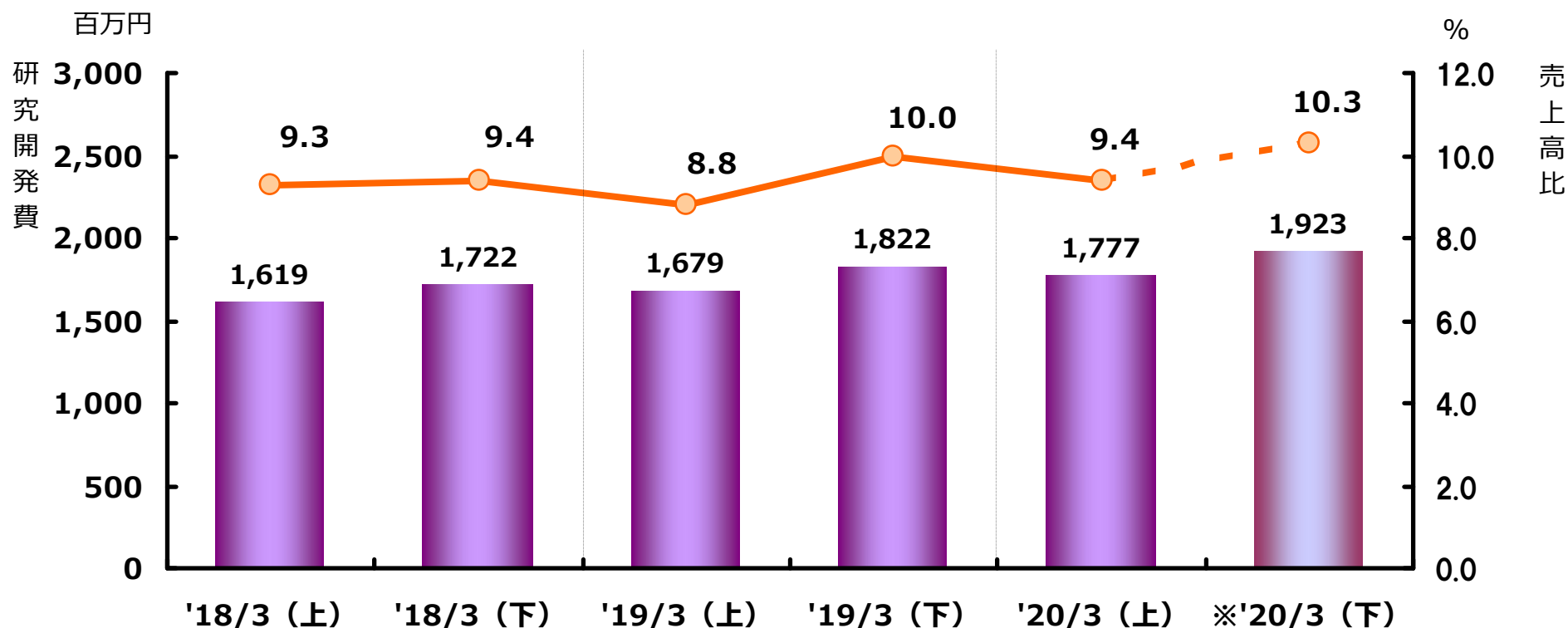
	19年3月期	20年3月期			
	通期実績	通期計画 ('19/5)	通期修正計画 ('19/11)	前期比	期初計画比 ('19/5)
設備投資	1,829	3,100	2,800	+53.1%	△9.7%
減価償却費	1,413	1,800	1,600	+13.2%	△11.1%



研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

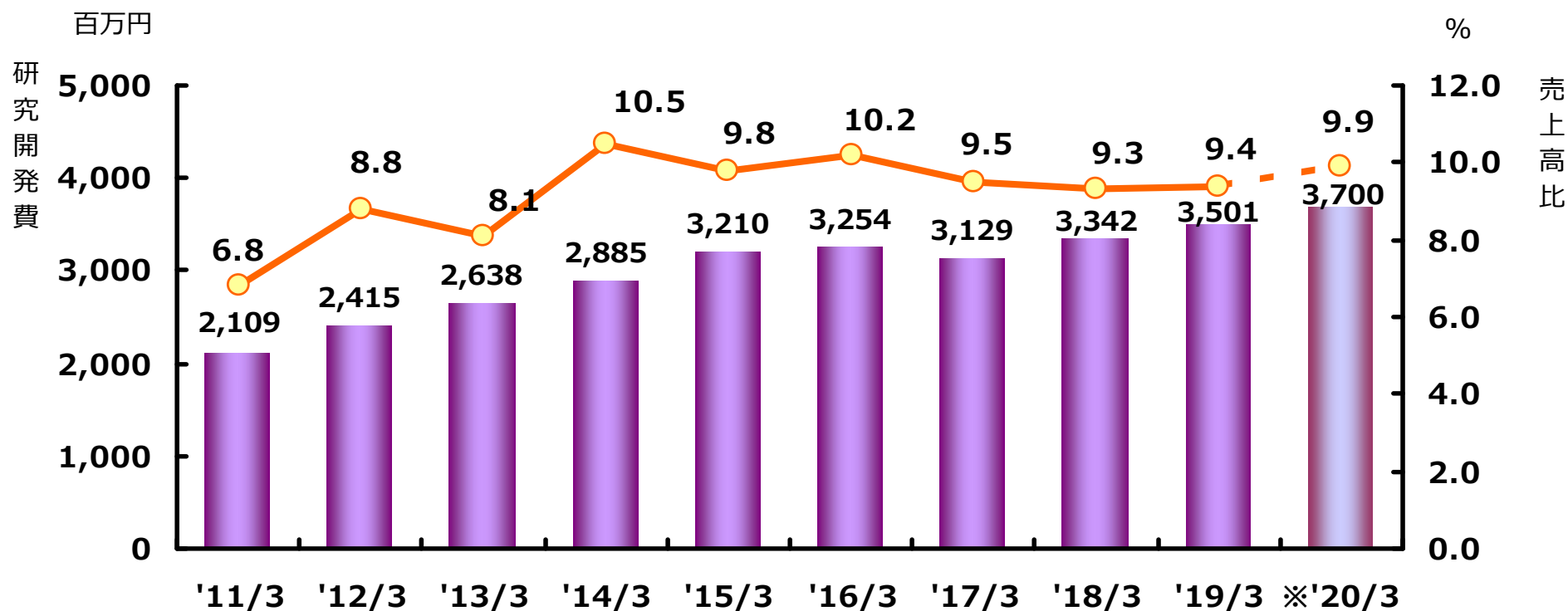
	19年3月期		20年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画('19/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比('19/5)	下期計画('19/5)	下期修正計画('19/11)	前年同期比	同年前期比	計画比('19/5)
研究開発費	1,679	1,822	1,800	1,777	+5.8%	△2.5%	△1.3%	1,900	1,923	+5.5%	+8.2%	+1.2%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	19年3月期	20年3月期		
	通期実績	通期計画 ('19/5)	通期修正計画 ('19/11)	前期比
研究開発費	3,501	3,700	3,700	+5.7%



損益分析

営業利益増減要因

19/9期予想→19/9期実績

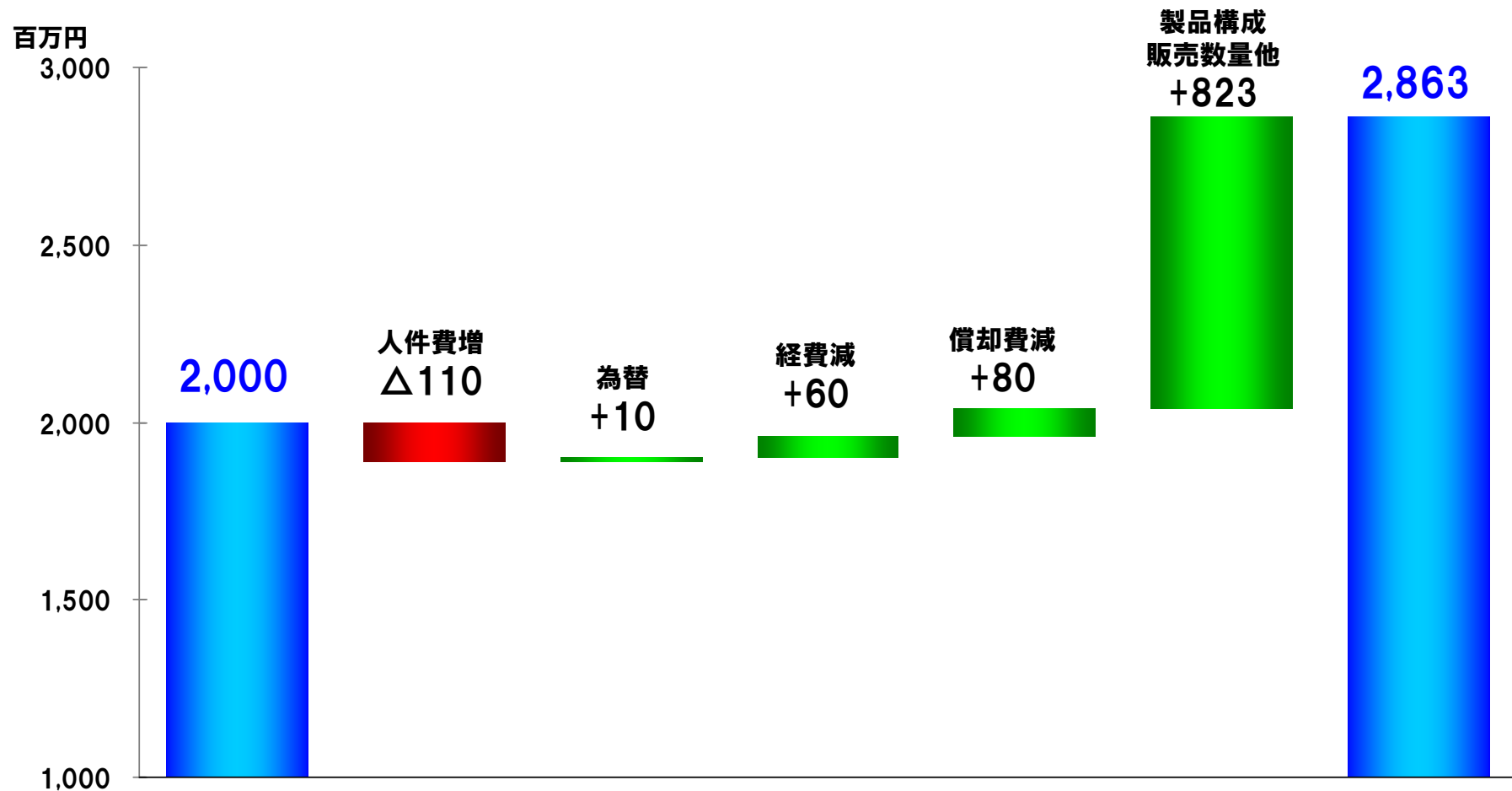
売上高 180億円

19/9期
予想

(利益増)
+863

188億円

19/9期
実績



営業利益増減要因

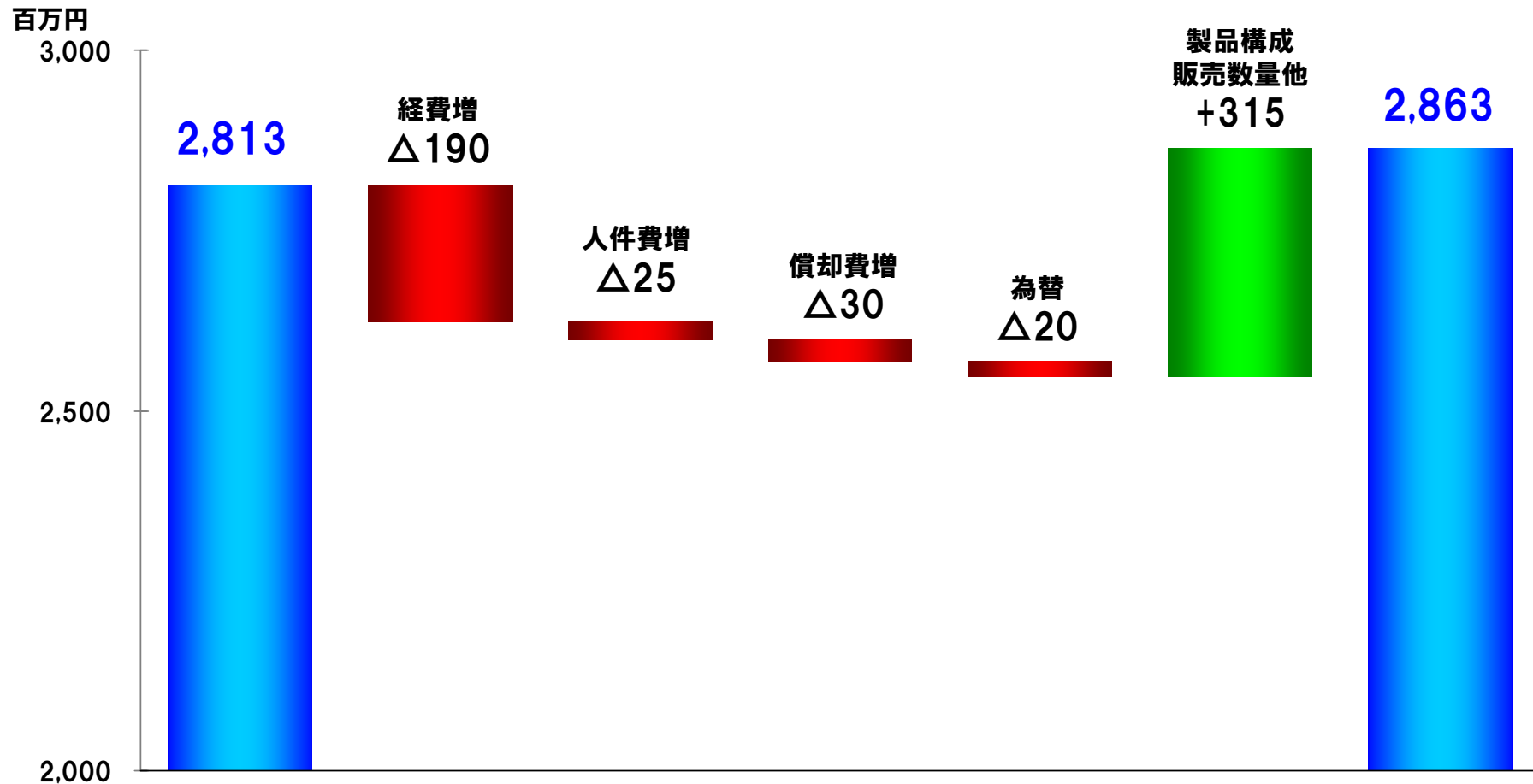
18/9期実績→19/9期実績

売上高 191億円

18/9期
実績

(利益増)
+50

188億円
19/9期
実績

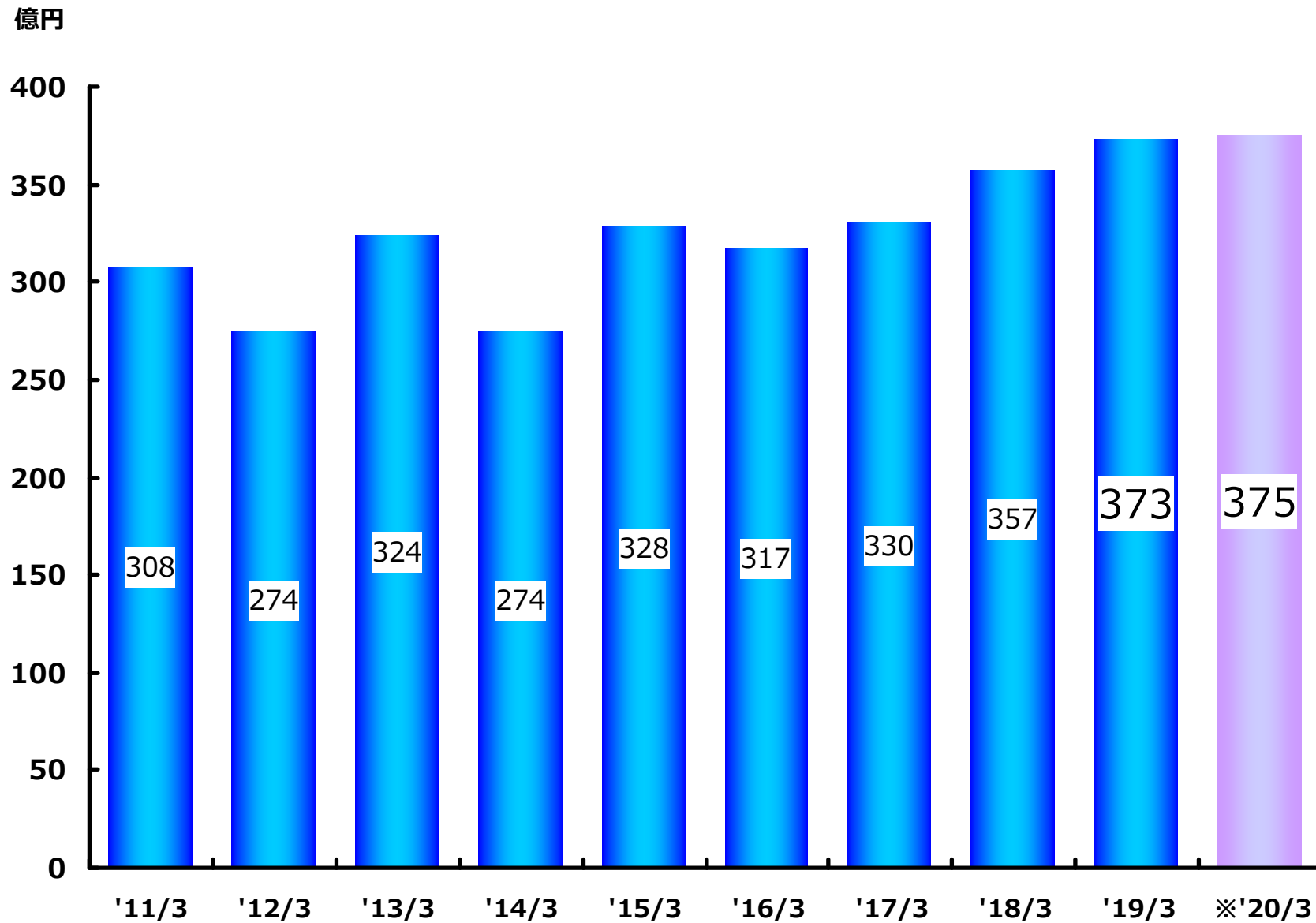


補足説明資料 マーケットデータ等

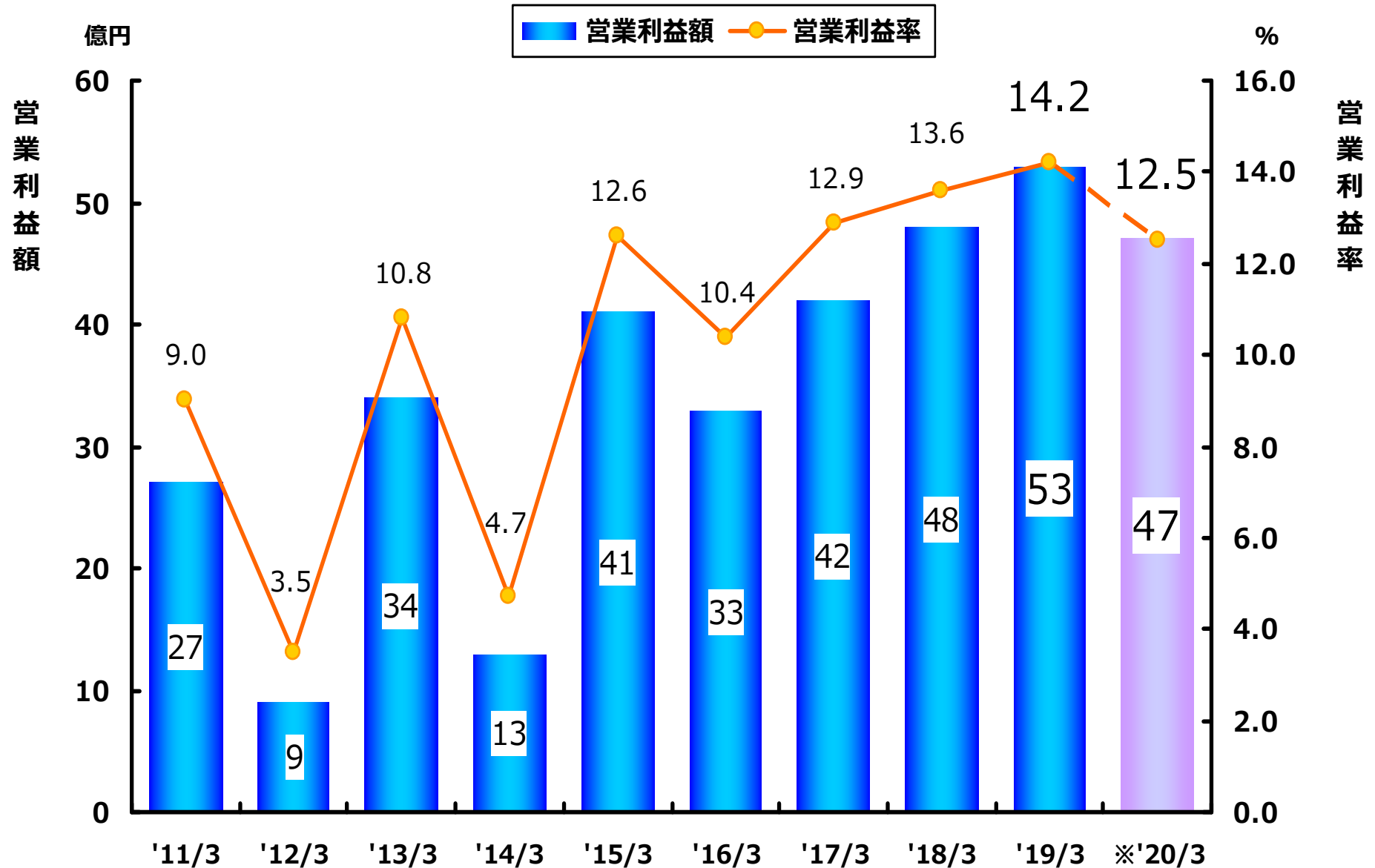
グループ人員 内訳

(人数)	19年3月期 (3月31日現在)		20年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時社員 ※	正社員	臨時社員	前期末増減	
					正社員	臨時社員
フジミインコーポレーテッド	588	193	616	195	+28	+2
フジミコーポレーション	114	3	110	1	△4	△2
フジミ台湾	77	1	83	2	+6	+1
フジミマイクロテクノロジー	66	7	66	5	±0	△2
フジミヨーロッパ	5	1	5	2	±0	+1
フジミ韓国	6	0	4	1	△2	+1
フジミ深圳	5	1	4	0	△1	△1
合 計	861	206	888	206	+27	±0

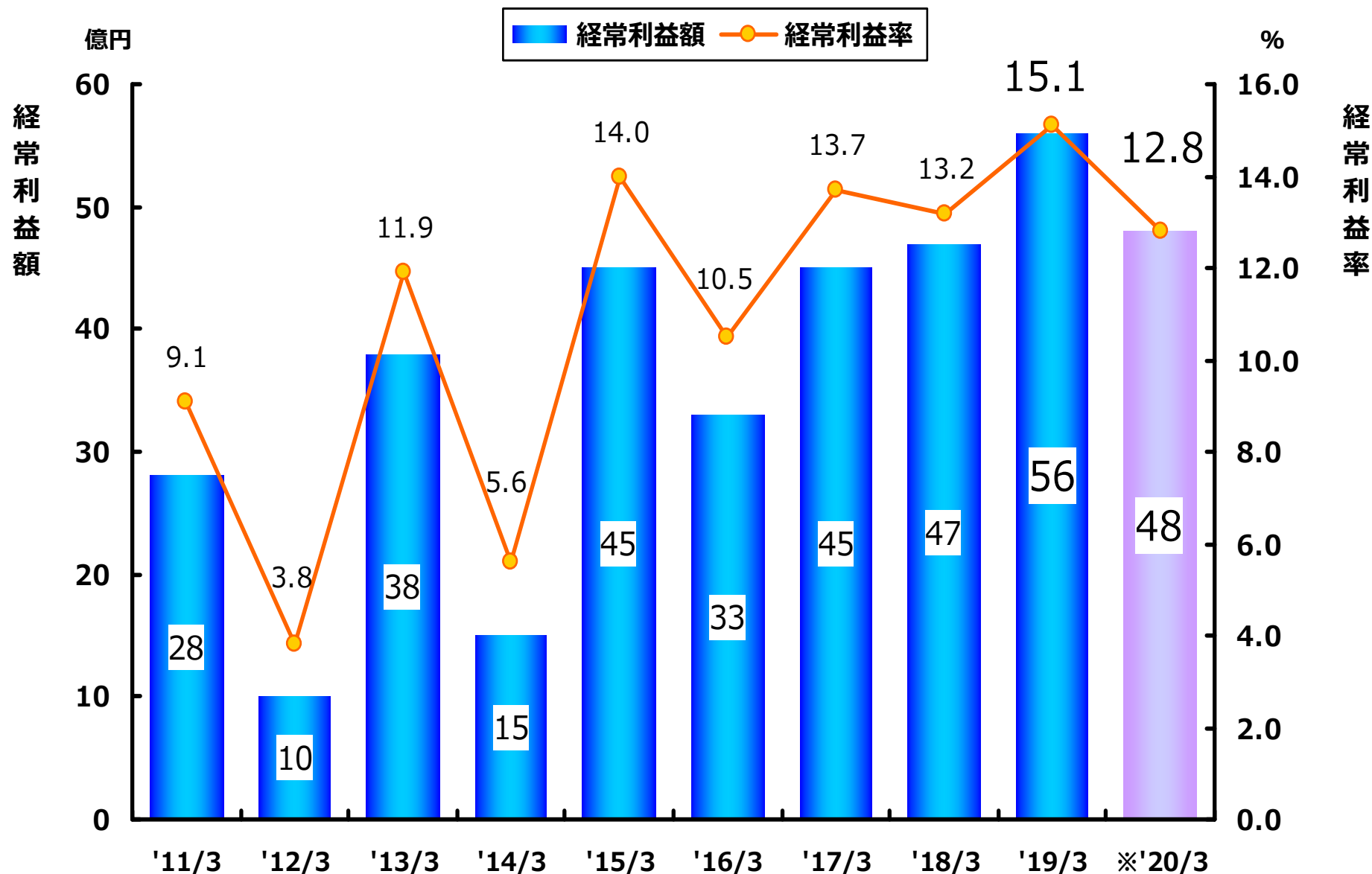
売上高 (通期)



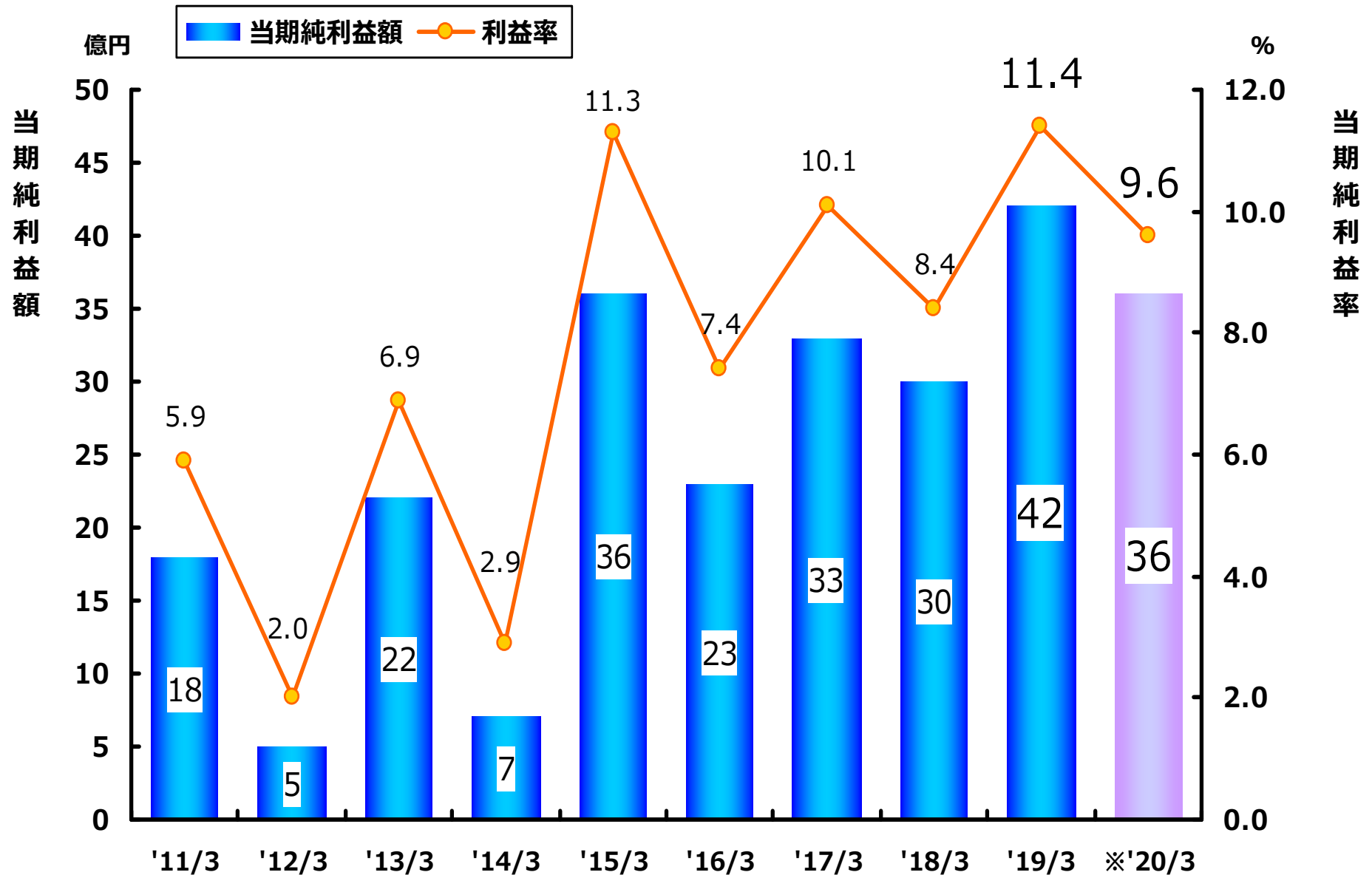
営業利益 (通期)



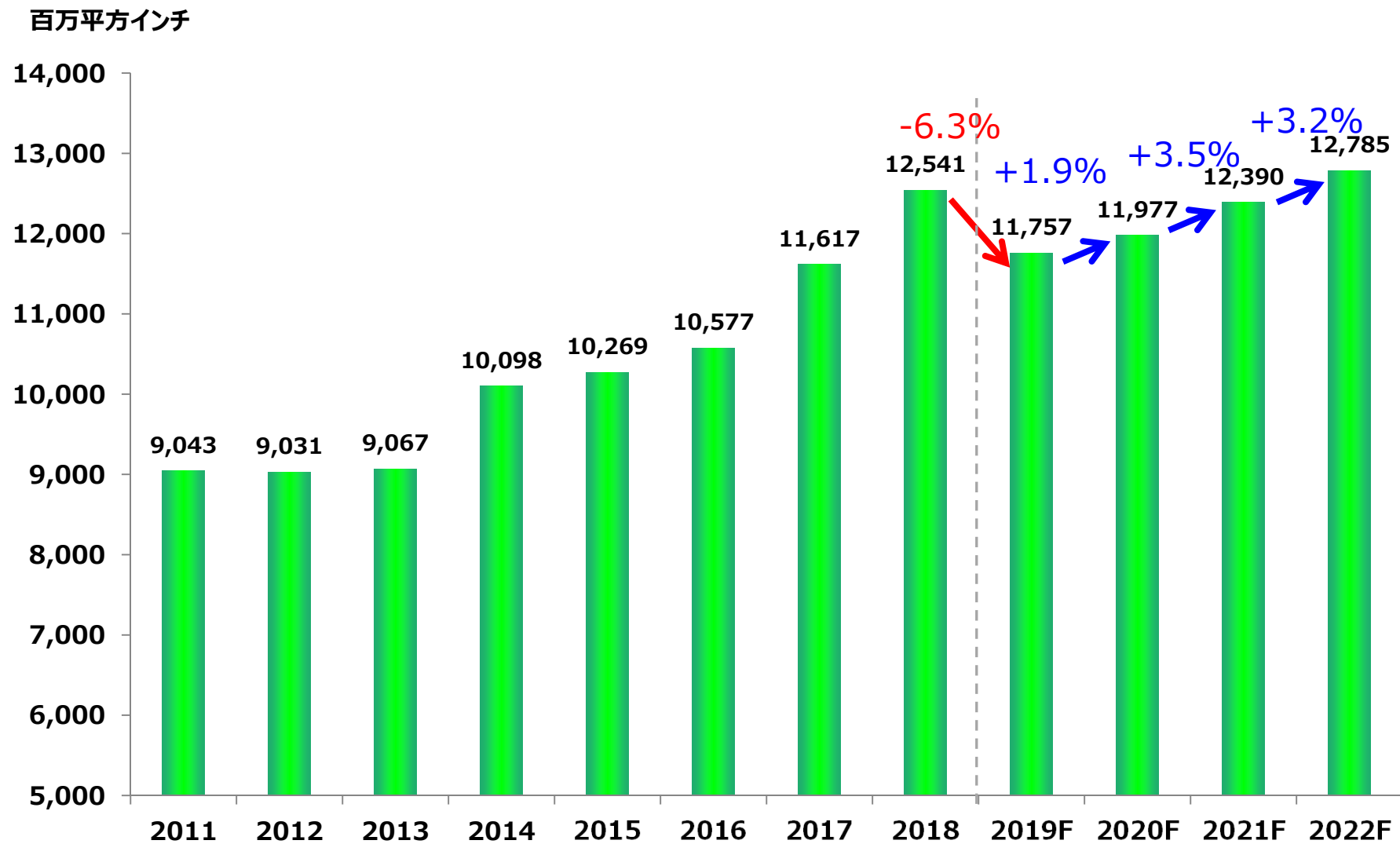
経常利益 (通期)



当期純利益 (通期)

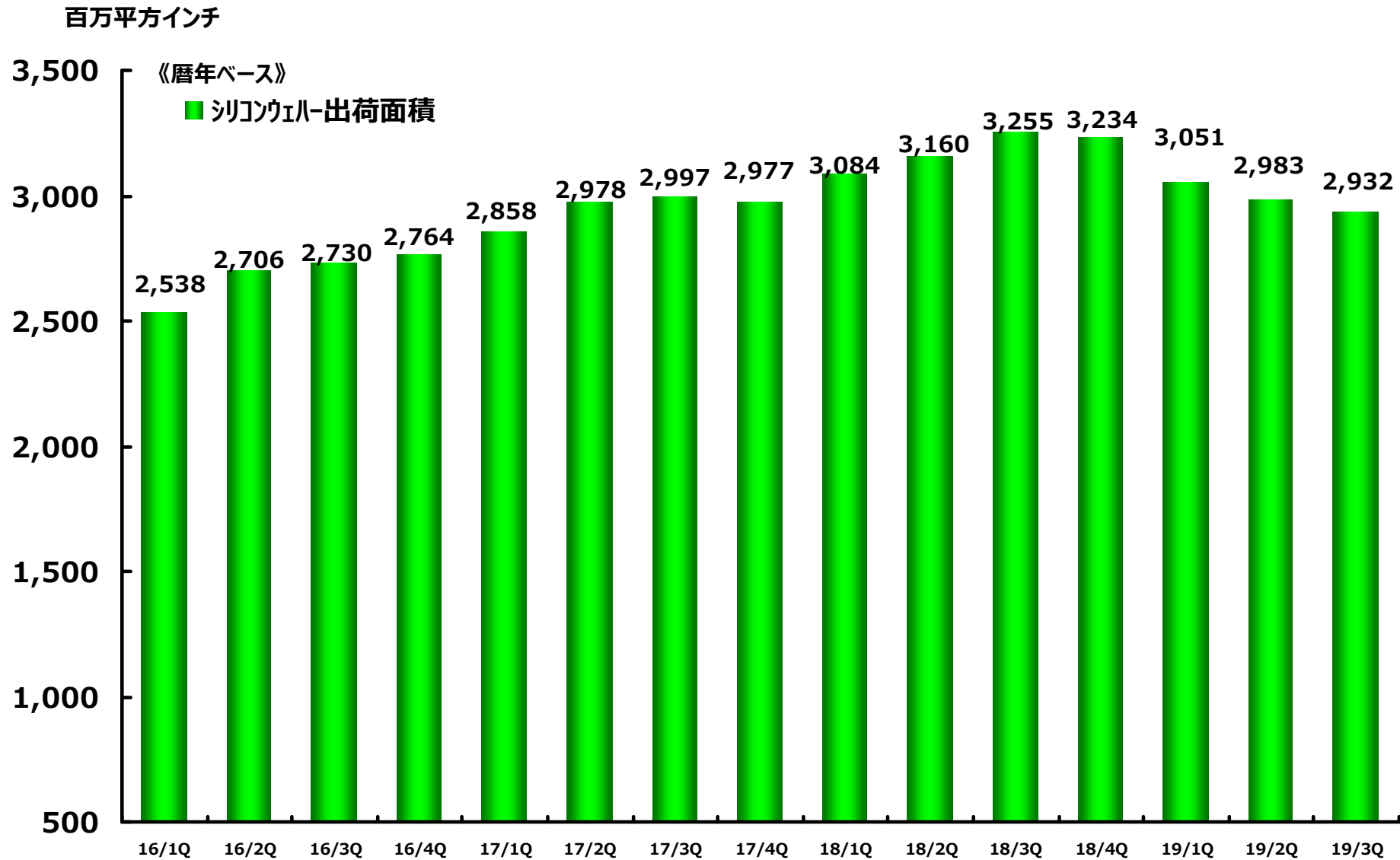


シリコンウェハ需要予測（出荷面積換算 全口径）



出所：SEMI（Semiconductor Equipment and Materials International）

シリコンウェハ-出荷面積 (四半期)



出所：SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

半導体市場規模 (地域別)

(単位：10億ドル)

